

薄膜の密着強度評価

<分析手法>

プリント基板配線部のレジスト／銅界面の密着強度をSAICAS法※により評価しました。

※SAICAS: Surface And Interfacial Cutting Analysis System

<結果>

レジスト成膜条件を変化させた際の密着特性の差などのレジスト基本情報が得られました。

